4. システム選定及び基本設計要求

STRO

### 4-15. 観測機器の選定



#### 世界最先端の性能が必要とされ、新規開発要素が多い観測機器システムについては、国産の最新技術を採用しつつ、 コミュニティにおけるフロントローディングの成果を基本として、高い信頼性をもった開発が可能となるように選定した。

	サブシ ステム	基本仕様	選定結果	新規/ 現存	国産/ 輸入	詳細
1	НХТ	角度分解能:1.7分角以下 有効面積 (HXT+HXI): 300cm <sup>2</sup> 以上 (@30キロ電子ボルト)	Pt/C多層膜スーパーミラーの技術を用いた多重薄板積層光学系 を採用。同一の望遠鏡を2セット使用して大きな有効面積を実 現。 指向精度確保のため、 固定式光学ベンチに搭載。	新規	国産	p.35,36 参照
2	HXI	硬X線撮像能力 エネルギー分解能: 2キロ電子ボルト以下	テルル化カドミウム(CdTe)半導体とシリコン(Si)半導体のイ メージング素子を組み合わせて、約50キロ電子ボルト以上の広 いエネルギー範囲を検出。「すざく」で実証された低バックグ ラウンド化技術を継承。伸展式光学ベンチに搭載して焦点距離 12mを確保。	新規	国産	p.37,38 参照
3	SXT-S SXT-I	角度分解能 : 1.7分角以下 有効面積(@6キロ電子ボルト): - SXT-S 210 cm <sup>2</sup> 以上 - SXT-I 360 cm <sup>2</sup> 以上	「あすか」「すざく」と同様の「多重薄板積層方式」を継承し て 超軽量で大面積を確保。SXT-S、SXT-Iで同型の望遠鏡を使 用。NASA/GSFCを製造の中心とし、密接な日米協力で開発。	現存技術 の改良	国際協力	p.39,40 参照
4	SXS	エネルギー分解能: 7電子ボルト以下 視野:3分角以上	すざくで実証済みのセンサ技術を用いる。 冷却システムをできる限りロバストな設計にし、PMデュワーを 用いた性能実証を行う。	現存技術 の改良	国産+ 国際協力	p.41-45 参照
5	SXI	軟X線撮像能力 視野:18分角以上	国産X線CCDの採用。 アナログ回路のLSI化による読み出しシステムにより小型化、低 消費電力化をはかる。	現存技術 の改良	国産	p.46,47 参照
6	SGD	検出効率: 10%以上 (@100キロ電子ボルト) 検出器面積:200 cm <sup>2</sup> 以上 エネルギー分解能: 2キロ電子ボルト以下 角度決定精度:0.6度以下	多層のシリコン(Si)とテルル化カドミウム(CdTe)イメージング 素子による半導体コンプトンカメラとBGOアクティブシールド による狭視野コンプトンカメラ。ファインコリメータにより 150 キロ電子ボルト以下の角度決定精度を確保。	<sup> </sup> 新規 	国産+ 国際協力	p.48,49 参照



4-16. 衛星バスシステムの選定



ASTRO-H衛星バス系については「すざく」において採用された衛星バスを基本的に踏襲し、衛星 全体のサイズアップへの対応、さらなる信頼性の確保、必要な範囲での新規技術の採用を行った。

	サブシステム	基本設計要求	選定理由と選定結果	新規/現存	国産/ 輸入	フロントローディング
1	構造系	低熱歪みにより高精 度指向性を実現す る。	衛星構体および固定式光学ベ ンチの炭素繊維強化プラス チック(CFRP)化	現存技術の 改良	国産	「すざく」のものをベースに、より広範にCFRPを採用する とともに、熱歪みの伝搬を防ぐ構造(キネマティックマウ ント)を導入した衛星構造体を設計する。
2	熱制御系	観測機器を最適な温度 範囲に制御。冷凍機の 排熱を効率良く輸送。	温度制御系と温度測定系の統 合	現存技術の 改良	国産	小型科学衛星に搭載する熱制御系回路と同等のものを採用 する。
3	電源系	軌道上で必要な衛星電 カリソースを確保す る。	リチウムイオンバッテリの採用	現存技術の 改良	国産	リチウムイオンバッテリのサイクル寿命試験を実施中。
4	通信系	高速X帯通信によるテ レメトリ送信とS帯で のコマンド受信。	マルチモードトランスポンダ (MTP)の採用(高速S帯通信に よる冗長化)。	現存技術の 改良	国産	SDS-1衛星にMTPが搭載され、軌道上動作実証済み。
5	姿勢制御系	望遠鏡光軸を観測天体 に向けて高精度に指向 制御する。	姿勢制御のゼロモーメンタム方 式への変更。ホイールなどの国 産技術の採用。	現存技術の 改良	国産	MPC社のType-Lホイールを使用予定。角運動量は異なるが 基本設計が同じType-Mホイールは、2009年1月に打ち上げ られたGOSAT衛星に搭載され、現在まで問題無く動作して いる。Type-Lホイールの地上認定試験は出力トルク0.1Nm ものが2005年に完了し、現在、出力トルクを0.2Nmに上げ た改良型を開発中であり、どちらを使用するかは調整中。
6	データ処理系	観測機器の生成データ を処理・蓄積する。	全面的なSpaceWire標準I/Fの 採用によるネットワーク化。 国産宇宙用MPUの採用。	新規	国産	SDS-1衛星にSpaceWire インターフェース実証モジュール (SWIM)として搭載され、軌道上動作実証済み



ASTRO-H

4-17. 観測機器配置







1. 硬X線撮像システム (HXT+HXI)



## 4-18. 硬X線望遠鏡 (HXT) [1/2]

### HXT:硬X線 (>10キロ電子ボルト)領域の世界初の望遠鏡

国産ナノ技術による「スーパーミラー」を	・用い、従来 。				
は反射できなかったエネルギーが10キロ	電子ボルト	基本仕様	・角度分解能 < 1.7分角		
を越すX線を、約80キロ電子ボルト近く	まで反射で		・集光面積 > 300cm² (30キロ電子ボルトにて)		
を越す X 線を、約80キロ電子ボルト近く きるようにした日本独自の世界最先端技術 1万電子ボルトを超すX線は、従来のX線望遠鏡のよ はなく、ブラッグ反射の原理を用いる。広いエネル バーするために、厚さ数ナノメートルの重・軽元素3 を精密に制御し、連続的に変化させる。	まで反射で 桁。 うな全反射で ギー範囲を力 薄膜層の厚み 動の概念図 nの -Hの 遠鏡反射 レ ss-section	開発方針 鍵となる 技術開発	<ul> <li>1.Pt/C多層膜スーパーミラーの技術を用いて開発する。必要な有効面積を確保するために多重薄板積層光学系を採用。焦点距離12mによって約50 キロ電子ボルト以上まで集光させる。</li> <li>2.原子1個分の大きさに相当する精度(薄膜界面の凹凸は0.3nm)で制御するための装置を名古屋大学を中心にプロジェクトで設置し1台あたり約1300枚の反射鏡をインハウスで製作。</li> <li>3.要求される有効面積は、同一の望遠鏡を2セット用意することで実現する。</li> <li>4.プログラム的リスクを軽減するために、できるだけ早く最終工程までのラインを立ち上げる。</li> <li>1.製造コストと時間を削減するために採用した大型(長さ20cm)の反射鏡において、反射鏡全面に亘って、基板の成形・一様な成膜ができること。</li> <li>2.80キロ電子ボルトもの高いエネルギー帯域のX線を囲いた望遠鏡の集光特性の較正</li> </ul>		
50nm of Pt/C	C ML-SM et al. 2004)				



1. 硬X線撮像システム (HXT+HXI)

**JAXA** 

#### HXTの開発方針 (1)

Pt/C多層膜スーパーミラーの技術を用いて開発する。必要な有効面積を確保するために多重薄板積層光学系を採用。焦点距離12mによって約80キロ電子ボルトまで集光させる。



ウォルターI型X線望遠鏡における焦点距離と集光面積。 10キロ電子ボルト以下は主に全反射の効果、10キロ電 子ボルト以上は主に多層膜による反射の効果。80キロ 電子ボルト程度の集光を行いたい場合は12mの焦点距 離が必要。



#### 鍵となる技術開発項目 (2)

4-19. 硬X線望遠鏡 (HXT) [2/2]



日本が誇る放射光施設SPring-8(蓄積電子エネルギー世界 最高)を用いた性能評価用のビームラインをSPring-8のパ ワーユーザーとして整備し(右図)、12mの焦点距離の硬X 線望遠鏡の特性評価を可能とした。





1. 硬X線撮像システム (HXT+HXI)



# 4-20. 硬X線撮像検出器(HXI) [1/2]

HXI:高分解能硬X線イメージングを 可能とする我が国発の最先端検出器 高エネルギーのX線やガンマ線の撮像を可能にす るものとして、世界に誇る日本の半導体技術が生	基本仕様	<ul> <li>・硬X線撮像能力</li> <li>・エネルギー分解能 &lt;2キロ電子ボルト</li> <li>・HXT(望遠鏡)と組み合わせて有効面積</li> <li>300 cm<sup>2</sup> (30キロ電子ボルトにて)</li> <li>1.世界に先駆けて実現したテルル化カドミウム</li> </ul>		
み出した新しい高効率半導体素子を用いた日本独 自の新型検出器。世界初の硬X線集光撮像による 非熱的宇宙の観測を実現 (ASTRO-Hの新技術)。		(CdTe)半導体を用いたイメージング素子技術を 基本とする。 2.シリコン (Si)半導体のイメージング素子と組み		
l0キロ電子ボルト以上のエネルギーを持つ硬X線、ガンマ線 の領域で、検出効率、エネルギー分解能、イメージング能力 に優れ、常温で動作する検出器はこれまで未開拓		合わせることで、数キロ電子ボルトから80キロ 電子ボルトの広いエネルギー範囲で、高感度焦 点面検出器とする。		
従来型検出器 <sup>放射線</sup> <sup>シンチレータ</sup> <sup>発光</sup> <sup>米導体結晶</sup> (CdTe) <sup>(CdTe)</sup> (CdTe)		3. 「すさく」HXD(硬X線検出器)で証明された 低バックグラウンド化技術(アクティブシール ド)を継承、超低雑音化をはかる。 4.要求される指向精度を確保するために、検出器 を伸展ベンチに搭載する		
・       ・	鍵となる 技術開発	1.250ミクロンピッチ両面ストリップCdTe半導体 イメージャー。 2.アナログ信号処理、ADCを内蔵したアナログ LSIの開発、および耐放射線を含む性能評価。 3.軌道上での宇宙線環境を模擬するシミュレー		
		3.軌道上での宇宙線環境を模擬するシミュレー ションプログラム開発。		



1. 硬X線撮像システム (HXT+HXI)



両面ストリップ型テルル化カドミウム検出器

・250µmピッチ x 128ch(片面)

・素子厚は 500 または 750 µm

#### HXIの開発方針 (3)

衛星伸展プレート

「すざく」HXD(硬X線検出器)で証明された低バックグラウンド化技術(アクティブシールド)を継承、超低雑音化をはかる。

HXIの開発方針 (1)、 鍵となる技術開発項目 (1) 世界に先駆けて実現したテルル化カドミウム(CdTe)半導 体を用いたイメージング素子技術を基本とする。



放熱板

(下図)世界で初めて実現した「硬X線/ガンマ線」イメジャー:400ミクロンピッチ両面ストリップ型CdTe検出器。高品質CdTe半導体、特殊電極技術、MEMSを応用した3D実装技術、低雑音アナログLSIなどの技術開発に基づく。

(下図) 試作センサーにより 取得した30キロ電子ボルト の硬X線イメージ。



鍵となる技術開発項目 (2)

アナログ信号処理とADCを 内蔵した多チャンネルアナ ログLSIの開発、および耐 放射線を含む性能評価





(上図)超小型化の鍵を握る独自開発の低雑音アナロ グLSIと基板。放射線医学総合研究所の重粒子ビーム を用いて耐放射線試験実施。現時点で問題なし。





# 4-22. 軟X線望遠鏡 (SXT) [1/2]

### SXT:超軽量大面積X線望遠鏡

ASTRO-Hで採用する軟X線望遠鏡は、NASAとの 日米協力により、20年にもわたる開発が続けられて きた軽量で大有効面積を実現する技術にもとづく。 「あすか」以来、我が国のX線衛星が成果をあげて きた鍵となる望遠鏡技術。

斜入射X線反射望遠鏡は、全反射条件を満たす小さな角度でX線が、 鏡面に入射するように作られる。X線の反射面には、金や白金など電 子密度の高い金属がコーティングされる。また、回転放物面と回転 双曲面の二つの反射鏡で二回反射することによって、光軸からはず れた方向での像の収差を小さくしたウォルターI型と呼ばれる光学系 がしばしば用いられる。



基本仕様	<ul> <li>角度分解能:1.7分角以下</li> <li>集光面積 (6キロ電子ボルトにて):</li> <li>SXS検出器と組み合わせて有効面積 210 cm<sup>2</sup></li> <li>SXI 検出器と組み合わせて有効面積 360 cm<sup>2</sup></li> </ul>
開発方針	<ol> <li>1.厳しい重量制限で大きな集光面積を実現するために、「あすか」「すざく」と大きな成果をあげた超軽量ながら大面積を確保する「多重薄板積層方式」を継承する。</li> <li>2.SXS、SXIで同型の望遠鏡を使用。</li> <li>3.NASA/GSFCを製造の中心とし、密接な日米協力で開発(リーダーは日本)。</li> <li>4.角度分解能の向上のため、製造遅延のリスクを避けながら、最新の技術成果をとりいれる(「開発研究」移行時の助言)。</li> </ol>
鍵となる 技術開発	<ol> <li>1.限られた開発期間の中で、角度分解能の向上のため に必要な高精度の形状を実現するための改良点の洗 い出し(「あすか」: 3.5分角、「すざく」: 2分角)。</li> <li>2.早い段階での角度分解能向上の見通しの確認。</li> </ol>

2. 軟X線分光システム(SXT-S+SXS)

3. 軟X線撮像システム(SXT-I+SXI)



### 4-23. 軟X線望遠鏡 (SXT) [2/2]

2. 軟X線分光システム(SXT-S+SXS)

3. 軟X線撮像システム(SXT-I+SXI)

### 鍵となる技術開発項目(1)

限られた開発期間の中で、角度分解能の向上のために必要な高精度の形状を実現するための改良点の洗い出し。

- ・大きな反射鏡の基板の厚さを150 $\mu$ mから、230 $\mu$ mもしくは300 $\mu$ mに厚くすることで、高精度の形状を実現。
- 反射鏡基板の成形に用いる金型の形状誤差を「すざく」の5µmから2µmに高精度化。
- ・用いる金型の数を、反射鏡の半径に合わせて「すざく」の40セットから150セットに増加。

鍵となる技術開発項目 (2): 早い段階での角度分解能向上の見通しの確認。

60セットの反射鏡を収めた試作望遠鏡を製作。性能試験で角度分解能1.3分角を達成。改良の方向性が正しいことを実証

諸外国の望遠鏡との集光面積対重量の比較



衛星	Chandra (米国1999-)	XMM-Newton (欧州1999-)	すざく (日本2005-)	ASTRO-H	
製作方法	研磨法	電鋳法	レプリカ法 (多重薄板積層方式)	レプリカ法 (多重薄板積層方式)	
積層数	4層	58層	175層	210層	
直径	120 cm	90 cm	44 cm	49 cm	
有効面積	740 cm <sup>2</sup>	1450 cm <sup>2</sup>	460 cm <sup>2</sup>	700 cm <sup>2</sup>	
総重量	1480 kg	440kg	20 kg	50 kg	
有効面積重量比	0.5 cm <sup>2</sup> /kg	3.3 cm <sup>2</sup> /kg	23 cm <sup>2</sup> /kg	14 cm <sup>2</sup> /kg	┣—
角度分解能	0.5秒角	15秒角	120秒角	90秒角	4



2. 軟X線分光システム(SXT-S+SXS)



4-24. 軟X線分光検出器 (SXS) [1/5]

SXS: 超精密分光観測かり能な最无端観測装置	▲◆□□□	・エイルキー分解能 / 電ナホルト以下
X 線観測が従来いわば「64色カラー画像」だっ		↓·視野 3分角
たのに対し、ASTRO_Hけ日米協力に上スマイク		・SXT-S(望遠鏡)と組み合わせて
		有効面積210 cm <sup>2</sup> (6キロ電子ボルトにて)
ロカロリメータといっ極低温技術を用い「2048	開発方針	
色総天然色画像」を実現するもので、これによ		
り高温ガスの運動が初めて測定可能となる。		済みのセンサ技術を用いる。その範囲で、最新
		の技術成果をとりいれる(「開発研究」移行時
マイクロカロリメータは、エネルキーを熱に変えて温度上		の助言)。
昇を精密に測定する(下図)。そのために、センサー部を		2世界の字宙田マイクロカロリメータの研究者の
50ミリ度に冷却することが必要である。		
X線エネルギー <b></b>		3.冷却システムをできる限りロバストな設計にす
		る。PMデュワーによる性能実証を行う。
	鍵とたる	1 衛星と冷却システムとの熱 機械式インター
		ノェース。 9 さくの栓袂に基づいたヘリリム排
		気パスの確保。
		2.ロケット打ち上げ時の振動の影響を考慮した設
2		1   0
熱伝導度		
		4.世界ではしめての極めて高いエネルキー分解能 
低温熱浴		を持つマイクロカロリメータを機上で較正する
		ためのセンサー較正用X線源(SRONが担当)。



2. 軟X線分光システム(SXT-S+SXS)



4-25. 軟X線分光検出器 (SXS) [2/5]



